

IC Taiwan Grand Challenge

競賽試行辦法

主辦單位：國家科學及技術委員會

共同主辦：國際半導體產業協會、台灣半導體產業協會、台北市電腦商業同業公會

2025/4/16 修正版

目錄

一、 關於 IC Taiwan Grand Challenge.....	1
二、 競賽領域	2
三、 報名資格	2
四、 競賽流程	3
五、 評審組成與評分項目	3
六、 獎勵內容	4
七、 獲獎義務	5
八、 其他注意事項	5
九、 聯絡方式	6
十、 附件.....	7

IC Taiwan Grand Challenge

競賽試行辦法

一、關於 IC Taiwan Grand Challenge

由台灣政府跨部會合力推動之晶創臺灣方案(Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program，簡稱 Taiwan CbI)，為善用台灣半導體高科技產業鏈優勢，以晶片結合生成式 AI 等關鍵技術，並以「結合生成式 AI+晶片帶動全產業創新」、「強化國內培育環境吸納全球研發人才」、「加速異質整合及先進技術」、「利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺」等四大布局，帶動全產業發展。

其中，為強化台灣全球最大 IC 新創聚落品牌，吸引全球尖端科技人才及創投資金來台，國家科學及技術委員會舉辦 IC Taiwan Grand Challenge，提供在地誘因包括彙整關鍵資源(如晶片下線、光罩、IP 服務)、攜手指標半導體企業投資媒合及成立公私合資專屬投資基金，藉此吸引全球潛力晶片應用技術方案新創、學研機構、人才參與徵選，打造台灣成為夢想現實之地。

為即早發掘潛力團隊、建立與台灣之鏈結，IC Taiwan Grand Challenge 於 2024 年首度舉辦，鎖定 IC 設計創新(IC design innovations)與晶片創新應用(Chip-based innovative applications)的全球新創及學研人才，透過競賽擇優篩選來台設立據點、鏈結國際與民間資金擴散晶片新創應用，以全球最完整的半導體產業生態、快速支援創意實踐。

台灣政府也期盼藉此獎項，整合在地 IC 設計、製造、封裝測試到產品流程，以跨國際、跨產學研的徵獎規模，將全球具創新潛力的未來之星匯聚在台，讓人才有發揮空間並實質落地、帶動商機同時驅動相關產業發展。

二、 競賽領域

運用 AI 晶片、AI 演算法、高速傳輸等開發以下類別的先進應用解決方案，或就核心技術進行突破創新：

- AI Core Technologies and Chips（如 AI 晶片設計、AI 系統、硬體加速技術、生成式應用、大語言模型、資安等）
- Smart Mobility（如電動車、自動駕駛、智慧城市、通訊產業、無人機）
- Smart Manufacturing（如智慧製造、IC 製程、機器人）
- Smart Medtech（如生物辨識、智慧監測、智慧醫療）
- Sustainability（如永續製造、節能創新、新能源）

三、 報名資格

(一) 規劃攜手台灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人，並符合下列資格均可提出：

1. 以公司身分參賽者，須為以報名日起算 8 年內成立的新創，但非公司性質法人、學研機構、自然人不在此限。
2. 不得為大陸地區（含港澳地區）之新創、人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
3. 前項所稱第三地區投資之公司，指大陸地區（含港澳地區）人民、法人、團體或其他機構對於第三地區之公司有下列情形之一者：
 - 直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾百分之三十。
 - 對該第三地區公司具有控制能力。

(二) 參賽單位須擁有該產品、技術或解決方案之智慧財產權或已取得合法授權使用。

(三) 參賽單位須於指定時間內提供構想書(初審)及進行簡報(複審)，構想書內容包括技術核心、目前已解決或獲得驗證情形、欲發展之商業

模式、市場拓展規劃，並提交 3 分鐘以內的 Pitch Video 等。

- (四) 曾於 IC Taiwan Grand Challenge 競賽獲獎之參賽者，於本次競賽中將不予核發獎勵，但法人或學研機構之計畫主持人如與先前參賽時不同，則不在此限。

四、 競賽流程

本獎項徵選為線上競賽，同一參賽者可不限次數參與，說明如下：

- (一) 共三梯次受理報名，第一梯至 2024/6/30 截止、第二梯 2024/9/4-2025/1/31 截止、第三梯 2025/3/26-6/30 截止。截止後兩週彈性開放參賽者補齊申請資料。實際截止期間以活動網站 ictaiwanchallenge.org 公告為主，主辦單位保留修改之權利。
- (二) 線上報名：有意參賽者可隨時至線上報名網址：ictaiwanchallenge.org 填寫報名資料並上傳所需提交之資料。
- (三) 資格審查：由主辦單位依據辦法進行資格審查及確認競賽類別。
- (四) 初審：構想書內容審查，依審查結果另行通知是否進入複審。通過初審之參賽者需提交 IC 新創加速平台資源需求申請表(附件一)及公司股東持股比例。
- (五) 複審：以線上進行報告與問題詢答，簡報者需具備流利英文聽說能力，全程以英文呈現(含簡報及答詢)，時間共計 20 分鐘。
- (六) 結果公告：主辦單位將依據需審查案件量安排審查時間，並於審查結束後兩週於競賽網站及國科會官網公布結果。

五、 評審組成與評分項目

- (一) 評審組成：邀請台灣產業、創投、政府部門等領域專家組成委員會，經由初審、複審階段選出獲獎者。
- (二) 評分項目：

評選標準	說明	評分 佔比
在地連結性	1. 具有來台資源需求及具體發展規劃 2. 能為台灣產業提供更寬廣的發展空間	40%
價值創造性	1. 能帶動科技創新潛力，創造社會福祉 2. 促成新產業鏈結或促進產業升級之貢獻 3. 引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效	40%
技術創新性	1. 於新興應用領域之創新性 2. 在製程、設計、新材料運用範疇具開創性 3. 能融入多元創新與整合跨域思維優勢	20%

六、獎勵內容：

- (一) 給予落地獎金美金3萬元/隊：獲獎者須於投資協議書合約簽訂前，至少1人在臺進行合計至少1個月產業媒合，將按照獲獎者需求量身客製規劃，並於獲獎者在臺報到後給予獎金。若遇不可抗力因素致使團隊無法配合主辦單位之安排與活動，得與主辦單位協調出合適之撥款條件。
- (二) IC 新創加速平台產業鏈結及在台晶片發展輔導：依獲獎者在臺發展資源需求，報經國科會審核同意後提供獲獎者在臺發展資助，將依實際需求提供計畫執行期間 EDA 工具使用、矽智財授權服務、IC 專業設計服務、晶圓共乘 Shuttle 等所需的晶片開發投資，每一獲獎者總上限 300 萬美金，並原則以 SAFE (**Simple Agreement for Future Equity**) 模式進行股權交換，若 SAFE 不適用於該國法規，將另議換股辦法。
- (三) 產業專家審查及業師輔導：將由台灣半導體產業資深技術專家、創投等籌組審議會，審查獲獎者所提平台資源需求，並視需求安排業師對獲獎者提供專業輔導諮詢。
- (四) 其他落地資源：取得台灣科技新創基地 TTA 空間進駐資格，(台北小巨蛋及南部據點，<https://www.taiwanarena.tech/>)及相關商務開

發輔導。專職輔導經理擔任獲獎者與顧問/業師間輔導橋樑，協助獲獎者串接所需資源。

七、 獲獎義務

- (一) 參賽者通過初審後需提交 IC 新創加速平台資源需求申請表（如附件一），確認獲獎後將依提供資源據以轉換為股權，由行政院國家科學技術發展基金佔股。
- (二) 獲獎者須於公告後三個月內完成 SAFE（Simple Agreement for Future Equity）投資協議書合約簽訂，主辦單位保有允許延後完成簽約，或因獲獎者不適用 SAFE 協議而另議換股辦法的權利。合約簽約對象須為公司，若獲獎者非公司，須於簽約前成立公司，才可以公司身分獲得被投資資格。
- (三) 獲獎者須配合來台進行實體商務鏈結發展，包含但不限於參與指定展會進行展示、技術發表、頒獎等活動，例如 2025/5/20-23 COMPUTEX/ InnoVEX、2025/10/16-18 台灣創新技術博覽會(TIE)。
- (四) 獲獎者需協助廣宣活動提交相關資料或參與宣傳，並配合主辦單位安排之在台對接行程活動及管考審查等事項。

八、 其他注意事項

- (一) 參賽標的內容嚴禁抄襲、翻譯、改寫、侵害智慧財產權等違法侵權之情形。
- (二) 參賽者須保證所有填寫或提出之資料均屬事實且正確，且不可冒用任何第三人之資料。
- (三) 參賽者應尊重評審委員會決定，除能具體證明其他參賽者違反本辦法相關規定，對評審結果不得有其他異議。
- (四) 參賽者應同意主辦單位基於參賽者管理、報名管理、活動期間身分確認、活動聯繫、競賽活動相關訊息聯繫及相關行政作業之目的，

得蒐集處理參賽者之個人資料。

- (五) 根據中華民國所得稅法，本競賽之獎金須依稅法相關規定預扣繳所得稅(本國人 10%、非本國人 20%)。獲獎者應提供其身分證明相關文件，供主辦單位報稅使用。
- (六) 參賽者同意將產品技術訊息授權予主辦單位(或主辦單位指定之第三人)基於非營利宣傳目的進行出版、著作、公開展示、及發行各類型態媒體宣傳使用。參賽者並有配合簽署相關授權文件之義務。
- (七) 凡報名參加此競賽者，即視為已充分瞭解本試行辦法中各條款，且願意完全遵守各項規定，如有違反本試行辦法者，主辦單位得取消其參賽及獲獎資格並要求其賠償主辦單位一切損失(包括但不限於訴訟費、律師費、對第三人之賠償)，已獲獎者應繳回已受領獎勵或獎勵之價額。
- (八) 主辦單位保留修改本試行辦法之權利，將滾動修正並即時公布，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理。

九、 聯絡方式

競賽執行：台北市電腦商業同業公會 Annett Wu

聯絡電話: +886 2 25774249 Ext. 312

Email： annett@mail.tca.org.tw

附件一：IC 新創加速平台資源需求申請表

辦法說明：

1. IC 新創加速平台藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創加速實現潛力產品。
2. 所提供之投資價值上限 300 萬美金。
3. 所提供之投資原則以 SAFE (Simple Agreement for Future Equity) 模式轉換為股權，若 SAFE 不適用於該國法規，將另議換股辦法，由行政院國家科學技術發展基金佔股。

詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)

☐ 產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：

☐ 產品規格：(請條列細節)

產品開發之資源需求：(可複選並說明)

☐ EDA tool 需求：_____

☐ IP 需求：_____

☐ IC 設計服務需求：_____

☐ 規劃投片晶圓廠：_____

☐ 製程節點：_____ nm

☐ 製程類型 type (GP, BCD, RF, Mixed-Signal...etc.)：_____

☐ 封測需求：_____

☐ 系統整合需求：_____

☐ 產品開發之時程規劃：

☐ 已接洽過之臺灣廠商：

其他需求說明：(可複選並說明)

☐ 商務發展需求：_____

☐ 募資需求：_____

☐ 在台設立公司：_____

☐ 其他（可條列說明，如產品開發需求之額外補充....等）：_____

股權資料內容

股權結構：

股東名稱	國籍	持股比例

各輪募資金額及估值(台幣仟元)：

輪次	時間	募資金額 (仟元)	估值 (仟元)	累積實收資本額 (仟元)

上述資料須提供相關佐證：包含「股東名冊」、「各輪次募資「股款匯入證明」、「資本額」

簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；未成立公司之團隊則需所有團隊成員簽署)：_____